

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-025

鸿合科技股份有限公司

关于公司及子公司2021年度向银行申请

综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟申请的综合授信额度情况

为满足公司2021年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在2021年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币18亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。

上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

二、对公司的影响

本次公司向银行申请授信额度是依据公司日常生产经营活动的实际需要，有

利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议；

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年4月7日